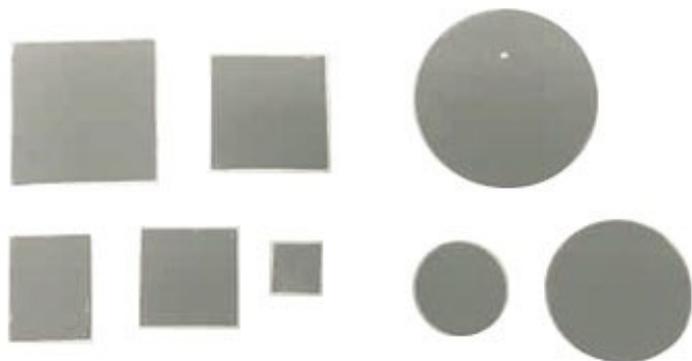


### ■ 产品用途

用于半导体、CPU、LED、通讯设备、新能源汽车、IGBT等传热作用

### ■ 产品特点

- 导热性能强，可快速加热或降温
- 40-60℃低压软化相变膜，填充性能好
- 良好的界面适用性，热失控风险低，使用时间长
- 导热性能代替硅脂，不会出现外溢，可靠性更高
- 标准厚度：0.2mm、0.25mm、0.3mm、
- 形状可按要求裁切
- 符合环保环评要求



### ■ 产品规格

型号	厚度mm	载体	导热系数 W/m-K	相变点 °C	长期使用温度 °C
测试标准	ASTM D374	PI	ASTM D5470	—	—
BN-PM1040	0.2-0.5	无	4.0	40-60	-40~150
BN-PM1050	0.2-0.5	无	5.0	40-60	-40~150
BN-PM2020	0.1-0.4	PI	2.2-2.5	40-60	-40~150
BN-PM2020A	0.1-0.4	PI	2.8	40-60	-40~150